



【即时发布】

2025年2月25日

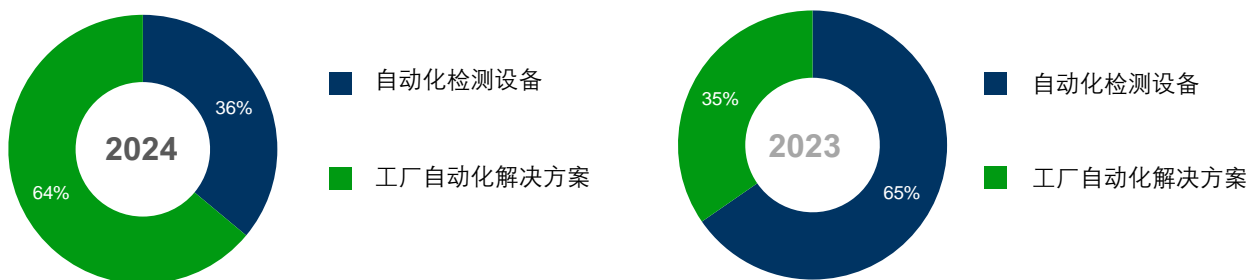
FAS 分部推动了增长并重塑了 PIL 的业务结构； ATE 继续面临逆风

在香港联合交易所主板上市的槟杰科达国际有限公司（“PIL”或“本集团”），今日公布截至2024年12月31日的财务业绩。本集团收入为622.4百万令吉，年内溢利为107.1百万令吉，较去年同期分别下降约10.0%及24.7%。

财务亮点

	2024 令吉千元	2023 令吉千元	变动
收入	622,433	691,850	-10.0%
毛利	179,913	209,644	-14.2%
年内溢利	107,128	142,233	-24.7%
每股盈利 (仙)			
基本	4.51	5.97	-24.5%
摊薄	4.51	5.96	-24.3%

主营业务营收占比及趋势



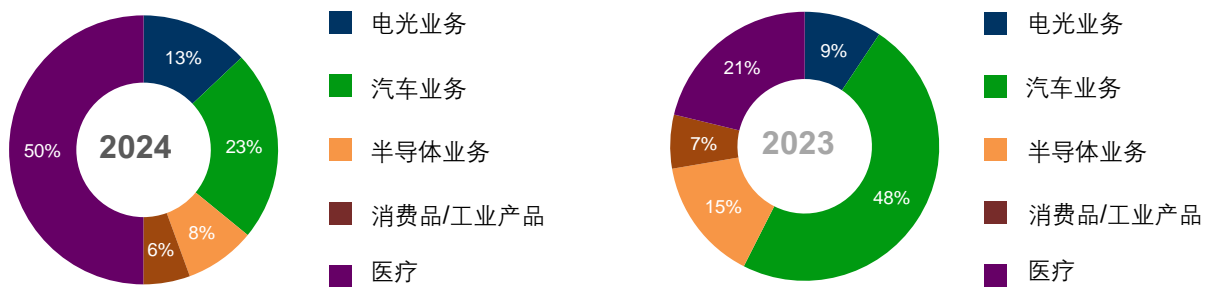
截至2024年12月31日，本集团主要收入来自于自动化检测设备(ATE)及工厂自动化解决方案(FAS)两个分部，其分别占本年度集团收入的约36.1%及63.9%。



以下概述各经营部门业绩表现，其中包含年内分部间收益。

	2024 令吉千元	2023 令吉千元	变动
收入按经营业务拆分			
自动化检测设备			
外部客户	224,390	452,254	-50.4%
分部间收益	9,929	538	
	234,319	452,792	
自动化解决方案			
外部客户	398,043	239,596	+66.1%
分部间收益	7,328	15,943	
	405,371	255,539	

业务营收占比（按客户拆分）



	2024 令吉千元	2023 令吉千元	变动
收入按客户拆分			
医疗	311,013	148,197	+109.9%
汽车	142,828	329,392	-56.6%
电光	80,703	65,315	+23.6%
半导体	52,923	103,794	-49.0%
消费品及工业产品	34,966	45,152	-22.6%



自动化检测设备(ATE)分部

于 2024 年，本集团的 ATE 分部按年下降 50.4%，收入由 2023 年的 452.3 百万令吉下降至 224.4 百万令吉。萎缩主要是由半导体 - 汽车行业放缓所致。于 2024 年，汽车分部占 ATE 分部收入的 59.3%，惟于 2024 年却大幅下滑 59.0%，严重影响 ATE 分部的整体表现。尽管全球电动汽车的销售量不断增加，惟仍显着集中于数个主要市场。根据国际能源署(IEA)的资料，于 2023 年，近 60.0%的新电动汽车注册来自中国，约 25%来自欧洲及 10.0%来自美国，相当于全球电动车销量总和近 95.0%。尽管电动汽车的长期增长前景仍然强劲，惟短期至近期出现的疲软迹象已导致整个产业采取较为谨慎的投资方式。然而，本集团仍然致力于支持其汽车客户，利用其在广泛测试解决方案方面的全面性来满足行业不断变化的需求。随着市况稳定及政策明朗化，预期汽车及电动汽车分部将会回升，为 ATE 分部重新增长创造条件。

于 2024 年，本集团半导体分部占 ATE 分部收入约 15.8%，较去年的 21.7%为低，反映更广泛的行业挑战。半导体行业仍然处于高度周期性，目前的低迷是由于消费性电子及汽车等主要市场的需求复苏逊于预期所导致。

相反，ATE 分部内的电光分部于经历连续两年的收缩后，于 2024 年强劲反弹，收入增长攀升至 2024 年的 24.1%，较 2023 年的 6.4%大幅增加，达到值得称许的 87.5%的双位数增幅。此强劲复苏主要是由于智能手机及其他消费装置采用升级环境光感测器，带动对本集团旗舰智能感测器测试设备的需求增加。随着先进的光电功能日趋普及，本集团已具备战略优势以利用此增长势头。

尽管 2024 年面对种种挑战，本集团仍会坚定不移地致力成为行业领导者，并在竞争激烈的环境中保持领先地位。尽管宏观经济压力及特定行业的不利因素对 ATE 分部造成影响，惟对更定制化及精密的测试处理设备及解决方案的需求不断增加，为该分部的复苏及未来增长提供令人鼓舞的迹象，尤其是在迎合人工智能 AI 市场的复杂测试及组装设备方面。



工厂自动化解决方案(FAS)分部

FAS 分部于过去四年持续录得双位数字的增长。于回顾年度内，该分部已成为本集团的主要收入来源，对本集团总收入的贡献率达 63.9%。FAS 分部的收入增长 66.1%，由 2023 年的 239.6 百万令吉增至 2024 年的 398.0 百万令吉。此显著增长创下新纪录，并进一步巩固该分部对本集团整体表现的贡献。

FAS 分部的增长势头主要受本集团专利的全自动化 i-ARMS（智能自动化机器人制造系统）的强劲需求所推动，尤其是在医疗行业分部，该分部继续成为 FAS 分部的主要贡献者，其收入占比由去年的 61.9% 扩大至 78.1%。除医疗分部外，消费品及工业产品分部及电光分部对本集团 i-ARMS 解决方案的需求于年内分别为 FAS 业务分部贡献 8.3% 及 6.7%。

在科技进步及多个行业日益采用工业自动化的趋势带动下，加上全球离岸外包的趋势，FAS 分部将继续保持上升轨迹，巩固其作为本集团长远增长及持续业务策略的主要推动力角色。



未来展望

「挑战中蕴藏机遇」

鉴于通货膨胀、利率政策、地缘政治紧张及供应链中断等多项宏观经济因素的微妙相互作用，本集团预期 2024 年观察到的许多趋势及全球经济状况将持续至 2025 年。尽管随着通胀趋于稳定及央行采取更宽松的货币政策，部分经济体可望出现温和复苏，惟仍存在重大不确定性。尤其是，特朗普政府的重新上台很可能会引发更大的波动，特别是对贸易及全球供应链敏感的行业。尽管存在该等不确定性，预期特朗普当选总统将同时带来经济机遇与挑战。本集团仍然专注并处于有利位置，以把握主要由 AI、汽车电气化及医疗制造自动化发展所带动的高增长分部的新机遇。值得注意的是，医疗分部继续占本集团目前订单的最大份额，其次是汽车及半导体行业。预计医疗分部将于 2025 年继续保持发展势头，而本集团亦注意到汽车及半导体行业的需求有增加的迹象。

FAS 分部近年来的上升轨迹令本集团感到鼓舞，本集团对 FAS 分部的持续增长感到乐观，其主要由各行各业日益采用制造自动化所带动。特别是由于医疗仪器生产及制药业对精确性、一致性及合规性的要求不断提高，医疗行业正经历重大的自动化转变。机器人、AI 及智能制造技术的发展加速此趋势，该等技术将提高效率并确保高品质标准。此外，为满足不断变化的产业需求，对可扩充性生产的需求与日俱增，进一步推动自动化的发展。本集团意识到此变革性转变，并且凭借其专业知识及以创新为导向的方法，已做好准备利用自动化在医疗行业领域日益扩大的作用。

除医疗行业外，本集团亦观察到可再生能源行业，尤其是太阳能领域的自动化整合趋势与日俱增。太阳能制造商正越来越多地利用先进的自动化技术来提高生产效率及扩大产能。为配合有关进展，本集团已取得太阳能制造商的订单，并继续致力支持业界转向采用自动化解决方案。透过提供专为太阳能生产及能源管理而设的 FAS 产品，本集团希望为全球更广泛采用可再生能源作出贡献。



凭借本集团全面而先进的汽车测试解决方案组合，本集团继续积极与半导体 – 汽车领域的客户合作。凭借碳化矽（「SiC」）的前端晶圆老化解决方案，以及最新推出用于 SiC 裸晶级测试的良品裸晶粒测试解决方案，加上晶圆重组能力，本集团已策略定位支援业界向高性能半导体的转型，而高性能半导体对于满足汽车应用的严格品质及可靠性标准至关重要。除汽车领域之外，由于 SiC 化合物具有独特的效率、散热性能及可靠性，满足 AI 需求的数据中心亦越加采用 SiC 基电源解决方案，以加强电源管理、降低能源损耗及提高整体运行效率。同样地，对高频宽记忆体晶片组的需求日增，亦带动 SiC 解决方案的采用，原因为 SiC 解决方案可实现更高的功率密度，对下一代运算及 AI 驱动的应用而言至关重要。本集团把握该等行业趋势，继续扩展其前端晶圆解决方案，包括先进的晶圆自动光学检测系统，以巩固其对创新的承诺，并加强其在高增长行业的地位。

随着产业朝高效能半导体转移，不仅各产业加速采用 SiC，先进封装亦逐渐成为下一代电子产品的关键元件。为配合此趋势，先进封装已成为本集团最具发展潜力的增长领域之一。本集团有系统地优先调配研发资源及能力投资，开始进军先进封装领域的策略性业务，专注于 2.5D 基板的尖端技术测试。此举为本集团持续努力多元化其产品供应的一部分，并把握各高性能领域对先进半导体封装技术日益增长的需求。先进封装，特别是 2.5D 及 3D 基板，对于高效能运算、行动装置、5G 基础架构、汽车系统、物联网等应用至关重要。该等技术能够实现更快的资料吞吐量、更小的外型尺寸以及更高的能源效率，对于 AI、自动汽车及先进电信等下一代应用均至关重要。2.5D 基板测试预计将在增强未来世代半导体的性能及功能方面发挥关键作用，从而使本集团成为这一高增长领域的主要参与者。

随着本集团继续提升其在高性能半导体及先进封装方面的能力，本集团亦正扩展其全球业务，以把握新的市场机遇，作为其整体增长策略的一部分。印度已成为主要的增长市场，其半导体产业在支援全球主要厂商的合约制造商活动不断增加的带动下迅速扩张。有利的投资环境及政府的支持进一步加强印度在全球半导体供应链中的角色及地位。在此背景下，本集团预期其测试处理设备的需求将不断增长，尤其是其转塔测试及视觉处理设备，原因为本集团已准备好在印度不断发展的半导体生态系统中担当举足轻重的角色。



除扩展印度市场外，本集团亦透过在欧洲及台湾设立专门的实体据点，加强在当地的布局，以进一步提升其技术能力。该等策略性的多元化发展，旨在特别提升本集团在晶圆级检测及先进封装测试的能力及专业知识，以支援半导体行业对产品品质、性能及可靠性日益增长的需求。透过扩展在该等主要地区的业务，本集团已准备就绪，以推动技术进步，加快开发下一代测试解决方案，并巩固其作为全球半导体价值链中主要参与者的角色。

尽管本集团已宣布拟将本公司私有化，惟该策略性企业发展并不影响其于 2025 年的增长前景。本集团将继续致力于其核心业务及策略性措施，同时不断推动创新及扩大市场占有率。凭借稳固的基础及明确的策略方向，本集团决心把握行业机遇，保持增长动力，而该策略性私有化让本集团可将资源用于策略性业务计划。此外，本集团新的第三园区生产设施将于 2024 年底落成，大大提高本集团承接更大型及更复杂项目的能力，以满足其多元化客户群不断变化的需求。扩充后的基础设施将于短期内成为加速本集团增长轨迹的主要动力。

关于槟杰科达国际有限公司

槟杰科达(1665.HK)是全球领先的自动化解决方案供应商，主要服务于亚太、北美和欧洲的半导体、汽车、电气和电子、医疗设备和消费工业产品领域的跨国制造商。本集团的集成自动化产品及解决方案涵盖创新、设计、制造及安装自动化设备及/或自动化制造解决方案。

想获取更多关于槟杰科达的公司信息，请访问公司网站: www.pentamaster.com

媒体关系及投资者关系: investor.relation@pentamaster.com.my